

次世代半導体デバイス価値創造特別講演会
“3次元実装時代のキープロセス/CMPの基礎と応用技術を展望する”

主催：九州大学システム情報科学府附属 価値創造型半導体人材育成センター
共催：精密工学会「プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会」、応用物理学会九州支部、
プラズマ核融合学会九州・沖縄・山口支部、九州大学プラズマナノ界面工学センター

日時：2024年2月22日（木）13時～17時半

場所：九州大学 [日本ジョナサン・KS・チョイ文化館](#)（伊都キャンパス）



プログラム（敬称略）

13：00～13：10 開会の辞 近藤 博基（九州大学 教授）

13：10～13：50 基調講演 土肥 俊郎（九州大学 名誉教授，株式会社 Doi Laboratory 代表取締役）
「半導体 Si と化合物半導体の加工プロセスとキー技術 CMP とその応用技術の現状と将来展望」

13：50～14：30 招待講演 檜山 浩國（株式会社荏原製作所 技監），黒河周平（九州大学 教授）
「プラナリゼーション CMP 装置とそれに関わる要素技術」

14：30～15：10 招待講演 會田 英雄（長岡技術科学大学 准教授）
「化合物半導体基板の加工プロセスと次世代プラズマ融合 CMP 技術—GaN 基板を中心として—」

15：10～15：30 休憩

15：30～16：10 招待講演 河瀬 康弘（三菱ケミカル株式会社グローバル戦略部 マネージャー）
「半導体ウエハにおける CMP 後洗浄」

16：10～16：50 招待講演 山村 和也（大阪大学 教授）
「プラズマおよび電気化学プロセスを援用した高能率無歪研磨技術」

16：50～17：30 招待講演 井上 史大（横浜国立大学 准教授）
「次世代 3D チップレット集積における CMP への期待と展望」

17：30～17：40 閉会の辞 近藤 博基（九州大学 教授）

17：50～19：30 名刺交換会

参加申込：

下記の URL または右の QR コードより，Google フォームにご登録ください。

<https://forms.gle/rhyry8bXGwCphJyw7>



問い合わせ先：

九州大学システム情報科学府附属 価値創造型半導体人材育成センター
近藤 博基（教授）

Tel: 092-802-3628, E-mail: hkondo@ed.kyushu-u.ac.jp